



IC-Optokoppler im SO6L-Gehäuse von Toshiba jetzt auch als Wide-Leadform-Option erhältlich

Neue Produkte als direkter Ersatz für Bauteile im SDIP6 (F Type) Gehäuse

Düsseldorf, 28 September 2017 – Toshiba Electronics Europe erweitert sein Angebot an IC-Optokopplern im SO6L-Gehäuse mit der Wide-Leadform-Bauform SO6L (LF4). Die Wide-Leadform-Option wird für drei High-Speed-Optokoppler-ICs sowie für fünf IGBT/MOSFET-Optokopplertreiber angeboten.

Die neuen Optokoppler können direkt auf Leiterplattenpads befestigt werden, die für bisherige SDIP6 (F Type) Produkte gedacht sind. Das maximal 2,3mm hohe SO6L (LF4) Low-Profile-Gehäuse ist 45% niedriger als der bisherige Gehäusetyp SDIP6 (F Type) und eignet sich somit für Anwendungen mit kritischer Bauhöhe, wie zum Beispiel zur Befestigung auf der Unterseite von Leiterplatten.

Der Pinabstand der SO6L (LF4) Version beträgt min. 9,35 mm und bietet eine garantierte Luft- und Kriechstrecke von min. 8,0 mm sowie eine Isolationsspannung von min. 5kVeff.

Damit künftig noch mehr der bisherigen beliebten Produkte im SDIP6 (F Type) Gehäuse durch den neuen Wide-Leadform-Gehäusetyp SO6L (LF4) ersetzt werden können, wird Toshiba die Wide-Leadform-Option um zusätzliche IC-Optokoppler im SO6L-Gehäuse erweitern.

Die neuen Optokoppler eignen sich ideal für eine Vielzahl von Applikationen, darunter High-Speed Digital Interfacing, I/O-Schnittstellen, SPS-en, intelligente Leistungsmodule und Inverter für Klimaanlage sowie Industrieanwendungen und Solarenergiesysteme.

Die Massenproduktion der IC-Optokoppler im SO6L-Gehäuse hat bereits begonnen.

Anmerkungen:

Der neueste Marktreport von Gartner würdigt Toshiba gemäß der Umsätze in 2015 und 2016 als führenden Hersteller von Optokopplern und beziffert den umsatzbasierten Marktanteil für das CY2016 mit 23%. (Quelle: Gartner "Market Share: Semiconductor Devices and Applications Worldwide, 2016" 30 March 2016.)

Toshiba wird weiterhin Produkte liefern, die die Anforderungen der Kunden erfüllen. Zu diesem Zweck forciert das Unternehmen die Entwicklung eines breit gefächerten Portfolios an Optokopplern und Fotorelais, die auf die jeweils aktuellen Markttrends zugeschnitten sind.

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) ist die europäische Niederlassung der [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet umfangreiche Produktlinien an im Bereich ICs und diskrete Bauelemente, einschließlich Speicher, Mikrocontroller, ASICs, ASSPs für die Märkte Automotive, Multimedia, Industrie, Telekommunikation und Netzwerktechnik. Zudem besitzt Toshiba Electronics Europe ein umfassendes Angebot an an Leistungshalbleiterlösungen und Speicherprodukten inklusive HDDs, SSDs, SD-Karten und USB-Sticks.

TEE wurde 1973 in Neuss gegründet und stellt heute Design-, Fertigungs-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten über seine Zentrale in Düsseldorf zur Verfügung. Weitere Niederlassungen finden sich in England, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien. TEE beschäftigt in Europa ca. 300 Mitarbeiter. Präsident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com